关于“基于同轴电缆的 5GoC 家庭网络验证方案研究”课题芯片小规模试制流片费用支出方案的说明

本课题组承担了国家重点研发计划课题“基于同轴电缆的 5GoC 家庭网络验证方案研究”（课题编号：2020YFB1805102）。根据课题研究任务安排和预算规划，本课题组拟采用 28nm 工艺制程并在联芯集成电路制造（厦门）有限公司（以下简称“联芯厦门”）进行家庭网络同轴宽带通信标准化测试专用芯片小规模试制流片（MPW）。“联芯厦门”是世界领先的集成电路晶圆代工企业 United Microchip Corporation（以下简称 UMC）的下属晶圆加工工厂（股权关系如附件 1），其 MPW 流片订单均由母公司 UMC 接收管理。UMC 一般也不直接接受需求量较小的用户订单，而是通过其在大陆地区的代理商接收汇总。联暻半导体（山东）有限公司为 UMC 在中国区的代理商（证明文件见附件 2）。本课题组拟与联暻半导体（山东）有限公司签署家庭网络同轴宽带通信标准化测试专用芯片小规模试制流片合同并委托其在 UMC 进行加工。所以该合同符合预算规划，并不存在流片单位不一致。特此说明。

课题负责人：赵玉萍

日期：2023.5.20

附件 1：联芯集成电路制造（厦门）有限公司的股权关系示意图

股东信息 4　发生变更时通知我　数据纠错　股权结构图 >　全部比例（4）　导出数据　天眼查

序号	股东（发起人）查看实际控股人 >	持股比例	最终受益股份	认缴出资额	认缴出资日期
1	United Microchip Corporation 大股东 实际控制人 股权结构 >	39.76%	39.76% 股权链 >	644091.0万元	2019-01-31
2	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司 曾用名 股权结构 >	32.97%	32.97% 股权链 >	534026.0万元	2024-03-31
3	厦门金圆产业发展有限公司 股权结构 >	23.1%	23.1% 股权链 >	374186.2万元	2024-03-31
4	福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙） 曾用名 股权结构 >	4.17%	4.17% 股权链 >	67476.2万元	2016-07-12

资料来源：https://www.tianyancha.com/company/2338000409

附件 2：联暟半导体（山东）有限公司与 UMC 的代理商证明书

代理商证明书

Certificate of Authorization

联华电子股份有限公司兹此证明联暟半导体（山东）有限公司为本公司认可之非专属代理商，代理本公司处理关于 MPW 方案服务事宜。

United Microelectronics Corporation hereby certifies
UnitedDS Semiconductor（Shandong）Co., Ltd.
as recognized and non-exclusive domestic representative

for the MPW (Silicon Shuttle) related services.

代理公司名称：联暟半导体（山东）有限公司
Domestic Representative Name:
UnitedDS Semiconductor（Shandong）Co., Ltd.

事务描述：关于 MPW 方案服务事宜

Description of Matter: MPW (Silicon Shuttle) related services

代理区域：中国区(含香港、澳门)

Authorized Territory: China Region

期限：2020 年 7 月 1 号 — 2023 年 7 月 1 号
Authorized Term: 07/01/2020 — 07/01/2023

授权人：联华电子股份有限公司	代理商：联暟半导体（山东）有限公司
姓名：	姓名：
职衔：VP	职衔：VP
日期：2020.7.22	日期：2020.7.1
地址：新竹科学园区力行二路三号	地址：济南市经十路汉峪金谷人工智能大厦21层